

www.qa-group.com



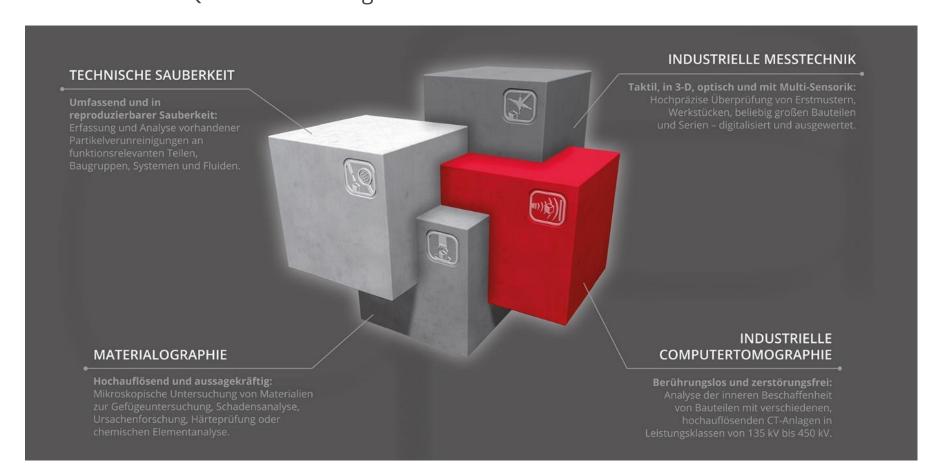






DIE BREITE. DIE TIEFE. DIE DYNAMIK.

Das ganze Spektrum industrieller Analytik als interaktives Dienstleistungsangebot – für umfassende Qualitätssicherung in allen Dimensionen





AKKREDITIERUNG.

Auf normenkonforme Qualität vertrauen.

- Akkreditiertes Prüflaboratorium nach DIN EN ISO/IEC 17025
- Akkreditierung aller Fachbereiche*

Vorteile der Akkreditierung:

- Unabhängigkeit und Objektivität (Third Party)
- Internationale Gültigkeit (ILAC)
- Verlässlichkeit durch Konformitätsbewertung
- Reproduzierbarkeit und Vergleichbarkeit
- Normenkonforme Mess- und Analysemethoden
- Höchste Anforderungen an den technischen Standard
- Kontrolle des Managementsystems und der Kompetenz des Fachpersonals





^{*} Den Umfang der Akkreditierung entnehmen Sie dem Anhang unserer Akkreditierungsurkunde. Diese finden Sie auf unserer Homepage.



UNSERE LEISTUNGEN.

- Probenpräparation und Schlifferstellung, inkl. elektrolytischen Ätz- und Poliertechniken
- Materialmikroskopische Analysen und Auswertungen
 - Schichtdickenmessung
 - Schweißnahtanalyse
 - Gefügeuntersuchung
 - Funkenemissionsspektroskopie (OES)
- Gefügeuntersuchung und Schadensanalyse
- Härteverlaufsprüfung
- Raster-Elektronen-Mikroskopie mit EDX
- Vollautomatische Partikelanalyse SmartPI für TecSa
- RAMAN-Spektroskopie
- FT-IR-Spektroskopie





PROBENPRÄPARATION.

- Trennen
- Warm- und Kalteinbettverfahren
- Schleifen (manuell & automatisch)
- Ätzen und Polieren (manuell, automatisch und elektrolytisch)

Präparation für Analysen zur Bestimmung von:

- Wärmebehandlungszustand und Güte
- Rückschlüsse auf den Herstellungsprozess
- Fehlerursache bei Schadensfällen
- Einschlüsse, Gefügezustände
- etc.









MATERIALMIKROSKOPISCHE ANALYSEN UND AUSWERTUNGEN.

Materialmikroskopie und Auswertung:

- Schliffauswertung
- Schichtdickenmessung
- Gefügeuntersuchungen



Mit dem Welding Expert "Clara Vision"

Schematische Darstellung	Sollwert			Istwert		
**				Bild 7	Bild 8	
Et Et	f st ET EL a	= = = =	100% 0,2 mm tmin mind. 0,7 x t2		0,87 mm	





Funkenemissions-Spektroskopie (OES-CCD-Spektrometer):

Analysemodule Fe-, Al-, Cu-, Ni-, Co-, Ti-, Mg-, Zn-Basis



MATERIALMIKROSKOPISCHE ANALYSEN UND AUSWERTUNGEN.

Gefügeuntersuchung:

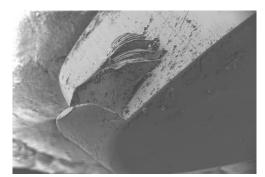
- im Schadensfall
- Produkt- und Prozessentwicklung
- Validierungen

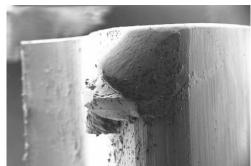
Schadensanalyse:

 Schadensuntersuchung an dynamisch und statisch belasteten Bauteilen, Bruchflächen und Rissanalysen etc.

Hauptziele der Schadensanalyse sind:

- Klärung der Schadensursache / Verursacherprinzip
- Maßnahmen zur zukünftigen Schadensverhütung
- Vermeidung von Folgeschäden
- Schadensdokumentation
- Klärung der Versicherungszuständigkeit









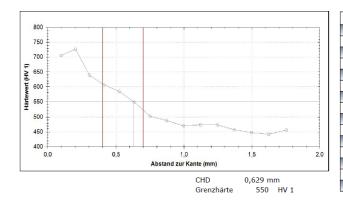
HÄRTEPRÜFUNG, HÄRTEVERLAUF, OBERFLÄCHENRAUHIGKEIT.

- Härteprüfung metallischer Werkstoffe nach Vickers
- Härteverlauf, CHD und NHT inkl. grafischer Auswertung am präparierten Schliff
- Alle gängigen Schweißverfahren









Probe	Reihe	Randabst.	Härte	Methode	Diagonale	CHD - Wert
Probe 51	Reihe 1	0,100	705	HV 1	51,299	0,629
		0,203	726	HV 1	50,524	
		0,304	639	HV 1	53,889	
		0,411	606	HV 1	55,312	
		0,522	584	HV 1	56,348	
		0,635	548	HV 1	58,162	
		0,751	502	HV 1	60,754	
		0,873	488	HV 1	61,661	
		0,996	470	HV 1	62,839	
		1,122	474	HV 1	62,577	
		1,247	474	HV 1	62,570	
		1,372	457	HV 1	63,734	
		1,499	447	HV 1	64,378	
		1,624	442	HV 1	64,778	
		1,754	456	HV 1	63,735	



- Zeiss EVO MA 25 mit EDX System (Wolfram-Kathode; 3,0 nm bei 30kV; 10 nm bei 3 kV)
- Zeiss Supra 40 VP mit EDX-System (Feldemitter; 1,9 nm bei 1 kV; 1,0 nm bei 15 kV)
- Leica Sputter-Coater EM ACE 600 (Schichtdicken bis 2nm; Platin und Kohlenstoff)









REM - Darstell- und Analyseverfahren:

Oberflächenstrukturen:

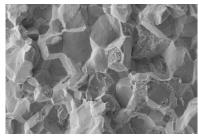
- SE-Detektor: Im Hochvakuum (leitende Proben)
- VPSE-Detektor:
 In variablem Niedervakuum (nicht leitende Proben)

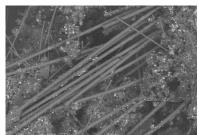
Materialunterschiede/Materialkontrasten:

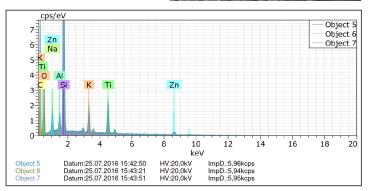
 BSD-Detektor: Hochvakuum (leitende Proben)
 Niedervakuum (nicht leitende Proben)

Chemische Elementanalyse:

EDX-Detektor: Generierung von Röntgen-Quanten



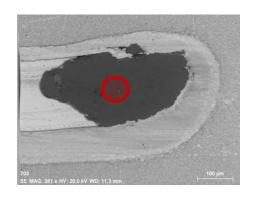


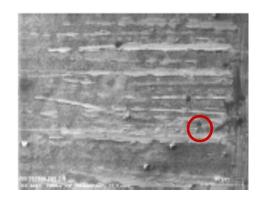


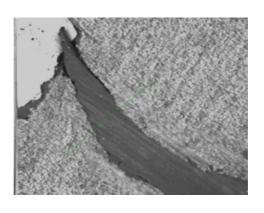


EDX-Analyse:

Verschiedene Darstell- und Analyseverfahren:







Einzel-Spot Messung

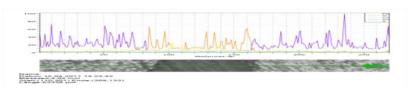
Absolutwert an markierter Stelle gekennzeichnet

Multi-Point Messung

Messwert aussagekräftiger durch Mehrfachmessungen

<u>Linescan</u>

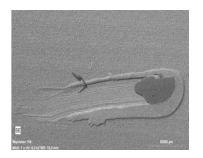
Darstellung des Elementverlaufs im Linescan farblich



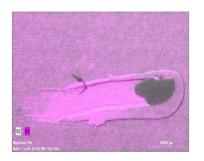


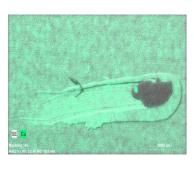
EDX-Analyse:

Mapping qualitativ: Darstellung der Elementverteilung farblich gekennzeichnet:



SS 10 Wayanin 10 Wayanin 10 Wayanin 10 Wayanin 10





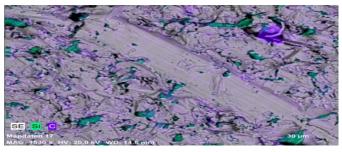
SE-Bild

Eisen

<u>Blei</u>

<u>Kupfer</u>

Hypermap quantitativ:



¹⁾ Qualitativ: Definition, welche chemischen Elemente vorhanden sind

²⁾ Quantitativ: Definition, welche chemischen Elemente vorhanden sind und in welcher Konzentration



Filterpartikelanalyse - Smart PI:

Spezial Software Smart PI von ZEISS

- Vollautomatische Partikelanalyse
- Bestimmung der Technischen Sauberkeit (VDA19/VDA 19.1 und/oder ISO 16232)

Beurteilung der Partikel nach Schadhaftigkeit

- Materialzusammensetzung (chemische Elementanalyse)
- Härteklassen (metallisch hart-, mineralisch hart- oder weiche Partikel)
- elektrisch leitfähige/elektrisch nicht leitfähige Partikel etc.

Detailanalyse von Partikeln

Gezielte Analyse einzelner Partikel



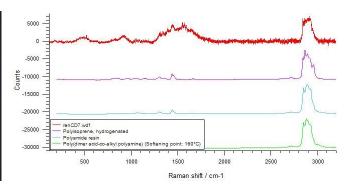




RAMAN – SPEKTROSKOPIE.

- Spektroskopische Untersuchung der inelastischen Streuung von Licht an Molekülen und Festkörpern
- Monochromatisches Licht durch Laser
 - Anregung mit 457 nm / 532 nm / 785 nm
- Analyse typischer Materialeigenschaften, Kristallinität, Orientierung, Zusammensetzung, etc.
- Detektion von organischen und anorganischen Partikel





Renishaw RAMAN inVia Reflex

Analyse eines Harz Partikels



FT-IR - SPEKTROSKOPIE.

- Eigenständiges FT-IR-Mikroskop (Infrarot-Spektroskopie) mit permanent justiertem RockSolid Interferometer
- Transmissionen und Reflexionen, automatisierte Messungen in abgeschwächter Totalreflexion (ATR)
- Automatisierte Einzelpunktmessung, automatisiertes Mapping und Imaging möglich
- Analyse typischer Materialeigenschaften, Kristallinität, Orientierung, Zusammensetzung, etc.
- Detektion von organischen und anorganischen Partikel



Bruker LUMOS

COOOD

Analyse eines organischen Partikels

				Сору	right 2004 Brul	ker Optik GmbH
0.20	-					
0.15	=					Λ
0.10	-	\wedge				
0.05	-		/ ^		M	
0.00] ,	/	All	 	//	\ \.

Dyed Rayon
black
Courtaulds North America Inc.
121
SYNTHETIC FIBERS ATR LIBRARY.S01
A Collection of Synthetic Fibres
Copyright 2004 Bruker Optik GmbH

Color	Hit Quality	Compound name	CAS Number	Molecular formula	Molecular weight
	874	Dyed Rayon			

Color	File	Path	Spectrum Type
	EXTRACT_AN 328706.2_000000.1	C:\Daten\BA 118243 Kauffmann	Anfragespektrum

Page 1 of 1



STANDORTE.

Von unseren Standorten ist eine weltweite Realisierung Ihrer Projekte möglich.









ANSPRECHPARTNER.

DEUTSCHLAND



Heidrun BonkLeitung Vertrieb
Technische Sauberkeit &
Materialographie

Telefon +49 (0) 7021 73781-64 Mobil +49 (0) 17656314620 Email h.bonk@qa-group.com



Daniel Buchmüller Leitung Vertrieb Industrielle Computertomographie, Industrielle Messtechnik & Materialographie

Telefon +49 (0) 7021 73781-61 Mobil +49 (0) 160 90170 819 Email d.buchmueller@qa-group.com



Julia Banzhaf Vertrieb Technische Sauberkeit & Materialographie

Telefon +49 (0) 7021 73781-67 Mobil +49 (0) 1726152346 Email j.banzhaf@qa-group.com



ANSPRECHPARTNER.

SCHWEIZ



Sascha Raschinsky COO Technologie und Vertrieb

Telefon +41 (0) 62 83900-86 Mobil +41 (0) 79 1551087 Email s.raschinsky@qa-group.com